

公司代码：688099

公司简称：晶晨股份

晶晨半导体（上海）股份有限公司

2019 年年度报告摘要



一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每十股派发现金红利 1.20 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 411,120,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 49,334,400.00 元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属上市公司股东净利润 158,041,814.36 元的 31.22%，不转增，不送红股，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。上述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本 411,120,000 股计算，在董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

公司 2019 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议及第一届监事会第十三次会议通过，本次分配预案还须经股东大会审议。

7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	晶晨股份	688099	不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	余莉	
办公地址	上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5	
电话	021-38165066	
电子信箱	IR@amlogic.com	

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司主要业务

公司主营业务为多媒体智能终端 SoC 芯片的研发、设计与销售，芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和 AI 音视频系统终端等科技前沿领域。公司为全球布局、国内领先的集成电路设计商，为智能机顶盒芯片的领导者、智能电视芯片的引领者和 AI 音视频系统终端芯片的开拓者。公司致力于超高清多媒体编解码、显示处理、人工智能、内容安全保护、系统 IP 等核心技术开发，整合业界领先的 CPU/GPU 技术和先进制程工艺，提供基于多种开放平台的完整系统解决方案，帮助客户快速响应市场需求。

公司业务覆盖中国大陆、香港、美国、欧洲等全球主要经济区域，借助全球性布局的区位优势和市场资源，公司积累了世界知名的国内外客户群。报告期内，公司依托长期技术沉淀，加大了对新技术、新应用领域的研究开发，公司积极布局了智能影像、无线连接及汽车电子等新市场，推动 AI 音视频系统终端的纵深发展。

2、公司主要产品及服务情况

公司目前主营产品为多媒体智能终端应用处理器芯片。公司多媒体智能终端应用处理器芯片集成了中央处理器、图形处理器、人工智能处理器、视频编解码器、音频解码器、显示控制器、内存系统、网络接口、输入输出子系统等多功能模块，用以完成运算、影像及视觉处理、音视频编解码及向其他各功能构件发出指令等主控功能，是智能终端设备的“大脑”，具有性能高、体积小、功耗低、发热小、兼容性强等特点，在视频编解码及视觉处理等方面可以实现多格式高兼容，集成度高。

报告期内，公司研究开发了智能摄像头芯片、连接芯片（包含 WIFI 和蓝牙功能，又称“WIFI

和蓝牙芯片”)以及汽车电子芯片,并已取得积极成果。智能摄像头芯片已实现量产,WIFI和蓝牙芯片处于试产阶段,汽车电子芯片处于客户验证(design in)阶段。

公司多媒体智能终端应用处理器芯片具体情况如下:

(1) 智能机顶盒 SoC 芯片

公司智能机顶盒 SoC 芯片主要有 FHD 全高清系列芯片和 UHD 超高清系列芯片,广泛应用于 IPTV 机顶盒和 OTT 机顶盒,该类机顶盒芯片主要包括数字信号的解码、处理、编码、输出等模块,以实现多种多媒体音视频信号在多媒体终端产品上的呈现。公司已推出搭载 64 位 CPU 架构的智能机顶盒芯片,在智能机顶盒芯片领域已实现工艺制程从 28nm 到 12nm 的突破,有效提升了芯片产品的性能、降低了功耗,产品工艺走在行业前列。代表性的芯片产品类型如下:

面向国内运营商市场的系列产品:该产品经过多年持续创新和升级换代,产品性能、稳定性优势明显,为公司智能机顶盒 SoC 芯片的主力产品之一;

面向海外运营商市场的系列产品:该产品主要采用业界领先的 12nm 制程工艺,产品已获得谷歌认证,新一代产品具备支持 AV1 解码能力;

面向国内外非运营商客户的系列产品:该类产品类型丰富,根据不同客户和市场对产品性能、制程工艺方面的需求,覆盖高中低市场。

公司 IPTV 智能机顶盒芯片方案被中兴通讯、创维等知名厂商广泛采用,相关终端产品已广泛应用于中国移动、中国联通和中国电信等三大电信运营商的设备,OTT 智能机顶盒芯片方案已广泛应用于境内外客户产品,如小米、阿里巴巴、Google、Amazon 等。

(2) 智能电视 SoC 芯片

智能电视 SoC 芯片是智能电视的核心关键部件,多年来,公司围绕全格式音视频解码技术不断突破创新,研发出一系列稳定性高、低功耗、高性价比的智能电视 SoC 芯片。目前主要有全高清系列芯片和超高清芯片系列,具有超高清解码、高动态画面处理、迭代的画质处理引擎等技术特点。代表性的芯片产品类型如下:

2K 全高清高性价比系列产品:支持 4K 超高清解码,超高系统集成度,目前为公司智能电视 SoC 芯片主流产品之一;

4K 超高清系列产品:主要采用业界领先的 12nm 制程工艺,支持 8K 超高清解码、远场语音和杜比音效,目前为公司智能电视 SoC 芯片主流产品之一;

高端系列产品:该产品除采用业界领先的 12nm 制程工艺之外,还内置神经网络处理器,支持远场语音升级版和杜比 vision,新一代产品还支持 AV1 解码。

公司的智能电视芯片解决方案已广泛应用于小米、海尔、TCL、创维等知名企业的智能电视产品。

(3) AI 音视频系统终端 SoC 芯片

随着宽带网络的持续完善、技术水平的不断提升和消费者对 AI 产品需求的日益提升,智能终端设备产品的品类不断增加,应用领域不断扩展。基于在多媒体音视频领域的长期积累和技术优势,公司致力于叠加神经网络、专用 DSP、数字麦克风、物体识别、人脸识别、手势识别、远场语音识别、超高清图像传感器、动态图像处理、多种超高清输入输出接口、多种数字音频输入输出接口等技术,通过深度机器学习和高速的逻辑推理/系统处理,并结合行业先进的 12nm 制造工艺,形成了多样化应用场景的人工智能系列芯片。

公司 AI 音视频系统终端 SoC 芯片主要有智能视频系列芯片和智能音频系列芯片。公司相关产品目前主要应用于智能显示、智能音箱、智能摄像头、智能开关控制中心以及汽车电子等终端产品。代表性芯片产品类型如下:

智能音箱系列产品:新一代产品采用业内领先的 12nm 制程工艺,支持远场语音升级版和 RTOS 系统(Real-time operating system,即实时操作系统);

消费类和行业类智能摄像头系列产品:内置神经网络处理器,支持 800 万像素高动态范围摄

像头输入和 4K 超高清编码，目前采用业内领先的 12nm 制程工艺。

智慧教育、智慧商显等系列产品：支持最高 5Tops 神经网络系列产品，支持摄像头输入和高分辨率屏显以及丰富的外围接口。

公司 AI 音视频系统终端芯片解决方案的合作客户包括百度、小米、Google、Amazon、JBL、Harman Kardon 等境内外知名企业。

(4) WIFI 和蓝牙芯片

为了进一步满足人工智能化产品市场需求，紧跟物联网发展趋势，公司加快了 WIFI 和蓝牙芯片的研究开发。目前，首款 WIFI 和蓝牙芯片产品已处于试生产阶段。首款 WIFI 和蓝牙芯片量产，将逐步应用于公司智能机顶盒、智能电视及 AI 音视频系统终端等全系列产品。

(5) 汽车电子芯片

汽车自动化、智能化、网联化的趋势带动了汽车电子芯片的市场需求，尤其是对于芯片计算和数据处理能力、图像和视频处理能力等需求提升，为汽车电子芯片市场带来新的发展契机。报告期内，公司加大了汽车电子芯片领域的投入，目前公司研发的汽车电子芯片处于市场推广阶段。该类芯片的代表类型为 V 系列产品。

V 系列产品应用于车载信息娱乐系统，产品采用业内领先 12nm 制程工艺，内置神经网络处理器、支持图形、视频、影像处理和远场语音功能，支持 AV1 解码，符合车规级要求，目前处于客户验证阶段。

(二) 主要经营模式

公司是专业的集成电路设计企业，采用国际集成电路设计行业通行的 Fabless 模式，即无晶圆厂生产制造，仅从事集成电路设计研发和销售的模式。在该经营模式下，公司只进行产品的研发、设计和销售，将晶圆制造、芯片封装和芯片测试环节分别委托给专业的晶圆制造企业和封装测试企业代工完成，即公司在完成集成电路布图设计后，将布图交予晶圆制造企业按照布图生产出晶圆，然后再交由封装测试企业完成封装、测试，从而完成芯片生产。公司取得芯片成品后，用于对外销售。目前，公司采用经销与直销相结合的销售模式。公司销售业务主要由公司的全资子公司晶晨香港负责，公司和全资子公司晶晨深圳负责少部分境内客户的销售业务。经销模式下，公司与经销商的关系属于买断式销售关系，在公司将商品销售给经销商后，商品的控制权转移至经销商。

研发是公司的核心竞争力，公司一直致力于打造强有力的研发技术和研发团队，目前，已经建立了一整套行之有效的研发规范和研发体系，涉及产品立项、产品规格制定、产品设计、产品验证及试量产等各个研发环节。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业属于“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”中的“集成电路设计”。

集成电路产业链主要分为集成电路设计、集成电路制造以及集成电路封装测试三个主要环节，同时每个环节配套以不同的制造设备和生产原材料等辅助环节。集成电路设计业主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品，处于产业链的上游。

集成电路具有产品换代节奏快、技术含量高的特点。集成电路设计行业是应用与产品导向、人才密集、创新密集、技术密集、知识产权密集型的行业，产品研究开发是该行业的核心驱动，按照摩尔定律，芯片上集成的电路数目、微处理器的性能等，每隔一个周期就翻一番，芯片设计

企业要不断开发新技术，将技术标准更新换代，以实现产品性能、性价比不断优化。集成电路设计企业通过高额的研发投入开发出先进的技术和产品，通过产品的竞争力获得更大的市场份额和更高的利润率，从而更多地投入研发，依此形成良性循环，推动企业不断发展。

集成电路设计行业高度的系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒。公司主营业务为多媒体智能终端 SoC 芯片的研发、设计与销售，提供系统级整体解决方案，公司 SoC 芯片集成了中央处理器、图形处理器、视频编解码器、音频解码器、显示控制器、内存系统、网络接口、输入输出子系统等多功能模块，用以完成运算、影像及视觉处理、音视频编解码及向其他各功能构件发出指令等主控功能，是智能终端设备的“大脑”。核心技术包括全格式视频解码处理、全格式音频解码处理、全球数字电视解调、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、高品质音频信号处理、芯片级安全解决方案、软硬件结合的超低功耗技术、内存带宽压缩技术、高性能平台的生态整合技术、超大规模数模混合集成电路设计技术等。行业内的后来者短期内很难突破上述核心技术壁垒。

集成电路作为信息社会和现代工业的根基，是国民经济和社会发展的战略性产业，是制造业的尖端领域之一，也是先进技术的代表行业之一。国家给予了集成电路产业高度重视和大力支持，出台了一系列政策，为产业发展建立了优良的政策环境，为企业创造了良好经营环境。我国的集成电路设计产业虽起步较晚，但具有巨大的市场需求和有利的政策环境等优势。

2019 年全球经济增长放缓，整体呈疲弱态势。根据联合国于 2020 年 1 月发布的《世界经济形势与展望 2020》显示，由于贸易局势以及投资的大幅缩减，全球经济增速在 2019 年降至 2.3%，为 10 年来的最低水平。在此背景下，全球半导体产业在 2019 年下滑明显，根据世界半导体贸易统计组织(WSTS)统计，2019 年全球半导体销售总额为 4,121 亿美元，与 2018 年相较下跌 12.1%。根据美国半导体行业协会统计，全球所有地区的半导体年销售额都有所下降，其中欧洲下降 7.3%、中国下降 8.7%、亚太/其他地区下降 9.0%、日本下降 10.0%，美洲地区下降 23.8%。

根据联合国于 2020 年 1 月发布的《世界经济形势与展望 2020》显示，2020 年全球经济增长率可能达到 2.5%，但在贸易局势紧张、金融动荡或地缘政治紧张局势升级的影响下，全球经济的复苏进程可能脱轨。目前，随着新型冠状病毒疫情的突然爆发和蔓延，给全球经济和半导体产业发展注入了新的不确定性和风险，2020 年半导体市场整体走势和产业表现前景不甚明朗。市场研究公司 IC Insights 连续下调 2020 年全球半导体市场销售额，从一月份预测的 2020 年同比增长 8% 至 3,848 亿美元，到四月份将预测的 2020 年下调为同比下降 4% 至 3,458 亿美元。据摩尔新闻网发布的新闻显示，据 IC Insights 预期，继全球芯片出货量在 2019 年衰退 6% 后，2020 年因新冠肺炎疫情对需求的冲击影响，全球 IC 总出货量恐将继续下跌 3%，并创下首次连续 2 年全球芯片出货量下跌的情况。

虽然国内外环境不甚明朗和乐观，但本公司将迎难而上、积极应对，降低国内外经济环境对公司产生的影响。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

集成电路产品高度的系统复杂性和专业性决定了进入本行业具有很高的技术壁垒，行业内的后来者短期内很难突破核心技术壁垒，只有经过长时间技术探索和不断积累才能与拥有技术优势的企业相竞争。

公司是国内较早从事多媒体智能终端芯片研发、设计和销售的高新技术企业，经过多年在音视频芯片领域的研发投入、技术积累和发展，自主研发了全格式视频解码处理技术、全格式音频解码处理技术、全球数字电视解调技术、超高清电视图像处理模块、高速外围接口模块、高品质音频信号处理技术、芯片级安全解决方案、软硬件结合的超低功耗技术、内存带宽压缩技术、高性能平台的生态整合技术、超大规模数模混合集成电路设计技术等 11 项关键核心技术。同时，公司推行研发、生产、销售的国际化战略，产品行销全球，历经磨砺，已发展成为全球布局、国

内领先的集成电路设计商，为智能机顶盒芯片的领导者、智能电视芯片的引领者和 AI 音视频系统终端芯片的开拓者，并已逐步把产品线延伸到包括消费类和行业类智能摄像头、智慧显示、汽车电子等新兴领域。在智能机顶盒芯片领域、智能电视芯片领域，公司产品的销售量位居国内市场前列，AI 音视频系统终端领域，累积了百度、小米、Google、Amazon、JBL、Harman Kardon 等境内外知名客户。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）智能机顶盒发展趋势

近年来，随着互联网的高速发展以及智能化进程持续推进，以 IPTV 机顶盒和 OTT 机顶盒为代表的网络机顶盒步入高速成长期，网络机顶盒把电视变成一个联网的智能终端，让用户直接通过互联网来观看视频内容。智能机顶盒近些年在保持增量发展的同时智能化发展趋势日益显著。据中国产业调研网发布的《2020 年中国机顶盒行业现状调研及发展趋势预测报告》显示，随着国家推进智慧城市、智能家居发展，智能机顶盒扮演的角色逐渐发生变化，不仅仅是视频传输，已逐渐转变为家庭控制、协调的中心枢纽，成为家庭信息的重要入口，市场地位更加重要，市场竞争环境也更加激烈。智能机顶盒作为视频产业发展的焦点，处于互联网与传统产业的交叉点，未来市场的发展将充满更多的创新与融合。受移动互联网的影响，智能机顶盒市场发展亦会受到更多不确定性因素的影响。智能机顶盒作为数字电视的终端设备，在数字电视业务发展中发挥着举足轻重的作用。在互联网+智能处理客厅经济背景下，中国在智能机顶盒市场上的发展已经从平均水平走到世界的前列，中国大陆市场的发展速度已经在全球处于领先。智能机顶盒作为终端电子的重要组成部分也在加快技术的发展更迭，这促使中国智能机顶盒从数量上的优势向产品质量上的优势转变。

（2）智能电视发展趋势

智能电视是具有全开放式平台，搭载了操作系统，用户在欣赏普通电视内容的同时可自行安装和卸载各类应用软件，持续对功能进行扩充和升级的新电视产品。智能电视扩展了传统电视功能，从显示技术上经历了黑白 CRT、彩色 CRT、PDP、LCD、LED 等不同技术的发展历程，不断给用户带来有别于机顶盒的、丰富的个性化体验。由于技术赋能，智能电视一经推出便大受欢迎，市场销量大幅增长。据中国产业调研网发布的《2020 年版中国智能电视市场调研与发展趋势预测报告》显示，我国城市化进程不断加快，现阶段已进入到高速城市化的起飞线上，这些客观因素为智能电视市场提供了广阔的发展空间。随着智能电视的不断完善，多屏互动技术的发展，智能电视逐渐成为消费者的新宠，随之引起了家庭收视习惯的改变，智能大屏成为家庭最重要的娱乐终端，相对于手机和电脑，人们更喜欢用大屏幕来欣赏高清电影、电视。随着人工智能技术与电视行业的融合，智能电视市场除了量的增长外，也正朝着 3D、更高分辨率、更高画质，更大尺寸、更智能化方向迈进，电视机从核心的影音功能到控制、内容都在发生改变。2019 年三部门（工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台）联合发布了《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022 年）》，提出按照“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022 年，我国超高清视频产业总体规模超过 4 万亿元，4K 产业生态体系基本完善，8K 关键技术产品研发和产业化取得突破，形成一批具有国际竞争力的企业。此行动计划并不具体针对某细分行业，而是对视频整条产业链的升级改造计划。在政策和技术的快速推进下，智能电视产业将迎来进一步发展契机。

（3）AI 音视频系统终端发展趋势

AI (Artificial Intelligence)，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人类智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。AI 人工智能应用领域十分广泛，随着政策的推动和技术的发展，人工智能的应用领域将不断拓宽，未来人工智能带来的科技产品将愈加丰富及多元化。AI 音视频

系统终端主要是指具有音视频编解码功能，并提供物体识别、人脸识别、手势识别、远场语音识别、超高清图像、动态图像等内容输入和输出的终端产品。按照应用领域的不同，AI 音视频系统终端芯片主要包括音频类智能终端和视频类智能终端，音频类智能终端主要包括智能音箱、耳机、车载音响等，视频类智能终端主要包括智能网络摄像头（机）、行车记录仪、智能门禁等。智能芯片在架构、技术、功能、工艺等方面具有较高的共通性。

根据工业和信息化部印发的《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020 年）》指出，当前，新一轮科技革命和产业变革正在萌发，大数据的形成、理论算法的革新、计算能力的提升及网络设施的演进驱动，人工智能发展进入新阶段，智能化成为技术和产业发展的重要方向。未来，随着云计算、大数据、5G、物联网、AI 等新技术的广泛应用，商业生态越来越开放，解决方案越来越多样化，应用场景越来越丰富，消费者对于智能化需求日益提升，相关的芯片技术将进一步升级、演进。公司着眼更长远的未来进行业务布局，抓住数字化、智能化的发展机遇，迎接全球人工智能终端市场的巨大发展契机。

（4）无线连接芯片（包括 WIFI 及蓝牙功能）发展趋势

随着智能家居、智能可穿戴设备等智能终端设备的普及，各种智能终端设备之间的互联互通成为了物联网领域实现智慧互联的基础。简单、稳定、可靠的联网能力是物联网实现智慧互联发展的最重要元素之一。与有线连接方式相比，无线互联具有应用广泛和组网便捷的独特优势，无线连接芯片通过局域网内的数据传输，从而有效实现物理设备与虚拟信息网络之间的无线连接。目前，无线连接技术已成为物联网领域实现智慧互联最流行的通信协议。鉴于物联网领域具有应用领域广阔、场景复杂多变等特点，其对无线连接芯片的集成度、功耗、数据处理速度方面有着较高的要求，无线连接芯片相关研发工作与下游应用领域高度相关。随着物联网、人工智能等新兴技术的深入应用，下游物联网应用领域快速增长，其实现智能互联的需求也将进一步扩大。根据工信部发布的数据及《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020 年）》显示，我国物联网加速进入“跨界融合、集成创新和规模化发展”的新阶段，并对各项指标制定了目标，到 2020 年，具有国际竞争力的物联网产业体系基本形成，包含感知制造、网络传输、智能信息服务在内的总体产业规模突破 1.5 万亿元。因此，公司布局的与主芯片配套的无线连接芯片方案，具有广阔的市场空间。

（5）汽车电子发展趋势

随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断变革，汽车正经历自动化、智能化、网联化的变革，汽车电子技术的应用和创新极大推动了汽车工业的进步与发展，使汽车具备了娱乐、办公和通信等丰富功能。近年来汽车产业大部分的创新来源于汽车电子技术的开发应用，汽车电子技术已成为衡量汽车档次水平的主要标志之一，芯片在汽车电子产业链中处于核心地位，代表着汽车先进的技术水平。

基于汽车智能化、网联化的大背景和趋势下，作为人机智能交互入口的车载显示屏需求将不断攀升。根据立鼎产业研究院网显示，车载信息娱乐系统、流媒体中央后视镜、抬头显示系统 HUD、全液晶仪表、中控屏多屏融合车联网模块实现人机交互，以满足驾乘者智能驾驶和娱乐需求，将推动车载显示的大规模使用。随之，车载显示的大规模使用将带动对汽车电子芯片产品的技术升级要求，尤其是对于芯片计算和数据处理能力、图像和视频处理能力等的需求提升，汽车电子芯片市场竞争格局有所改变，为消费电子芯片公司切入汽车电子芯片市场带来新契机。根据 Global Market Insights 的数据显示，2018 年全球汽车显示市场规模约为 150 亿美元，2019 年至 2025 年，全球汽车显示屏市场将能够保持至少 10% 的年复合增长率。

公司将过去长期积累的音视频技术延伸到智能汽车产业，充分发挥自身在音视频领域深厚的工程积累和技术优势，围绕车载娱乐信息系统、汽车后视摄像头，辅助驾驶等方面与汽车产业共同变革，共同发展。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	3,323,474,918.56	1,646,194,522.70	101.89	1,152,978,483.23
营业收入	2,357,733,386.83	2,369,069,435.42	-0.48	1,690,487,574.44
归属于上市公司股东的净利润	158,041,814.36	282,530,860.94	-44.06	78,091,337.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,481,323.64	270,925,168.87	-48.15	160,549,339.83
归属于上市公司股东的净资产	2,798,706,259.51	1,121,635,807.37	149.52	829,316,262.65
经营活动产生的现金流量净额	340,612,818.94	185,140,814.11	83.98	176,852,873.93
基本每股收益 (元/股)	0.41	0.76	-46.05	0.21
稀释每股收益 (元/股)	0.41	0.76	-46.05	0.21
加权平均净资产收益率(%)	9.24	28.98	减少19.74个百分点	11.00
研发投入占营业收入的比例(%)	19.58	15.88	增加3.70个百分点	15.80

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	561,610,165.22	567,220,806.55	577,470,355.34	651,432,059.72
归属于上市公司股东的净利润	46,273,375.04	60,013,164.52	25,935,604.55	25,819,670.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	46,081,490.81	50,157,141.55	24,410,069.17	19,832,622.11
经营活动产生的现金流量净额	-40,130,414.82	97,888,013.20	76,181,552.32	206,673,668.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)		19,038						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)		16,539						
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)		0						
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻结 情况		股东 性质
						股份 状态	数量	
Amlogic (Hong Kong) Limited		146,211,461	35.56	146,211,461	146,211,461	无		境外 法人
TCL 王牌电器(惠州)有限公司		41,770,381	10.16	41,770,381	41,770,381	无		境内 非国 有法 人
晶晨半导体(上海)股份有限公司未确认持有人证券专用账户		28,508,125	6.93	28,508,125	28,508,125	无		其他
华域汽车系统(上海)有限公司		20,165,001	4.90	20,165,001	20,165,001	无		国有 法人
华芯原创(青岛)投资管理有限公司—青岛天安华登投资中心(有限合伙)		19,303,144	4.70	19,303,144	19,303,144	无		其他
文洋有限公司		13,039,471	3.17	13,039,471	13,039,471	无		境外 法人

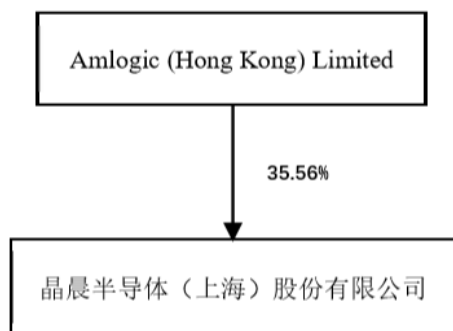
华胥基金管理（广州）有限公司—华胥（广州）产业投资基金管理合伙企业（有限合伙）		12,697,177	3.09	12,697,177	12,697,177	无		其他
北京红马未来投资管理中心（有限合伙）		10,723,971	2.61	10,723,971	10,723,971	无		其他
FNOF Invention Champion Limited		10,723,971	2.61	10,723,971	10,723,971	无		境外法人
上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）—上海尚颀增富投资合伙企业（有限合伙）		10,284,945	2.50	10,284,945	10,284,945	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明				股东华域汽车系统（上海）有限公司为上汽集团间接控股的子公司，上汽集团的全资子公司上海汽车集团股权投资有限公司为尚颀增富的有限合伙人之一（持有 20.14% 的份额），并持有尚颀增富的普通合伙人上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）40% 的份额；除上述情况之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				无				

存托凭证持有人情况

适用 不适用

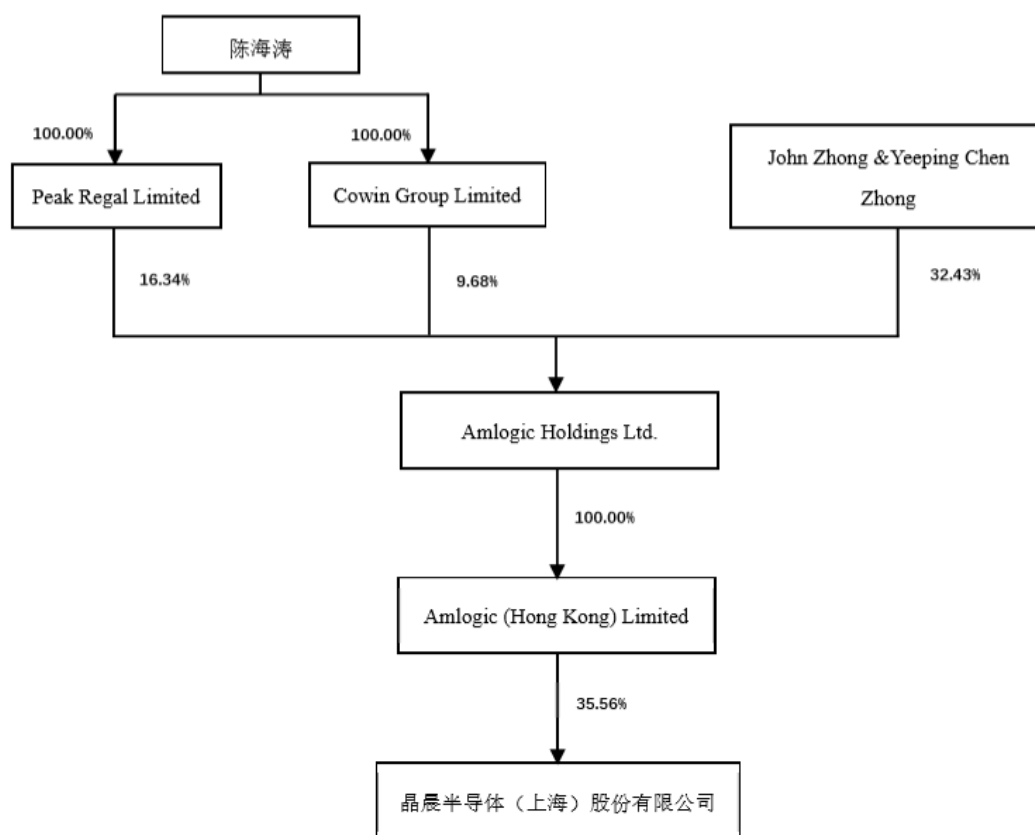
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,357,733,386.83 元，实现归属于母公司所有者的净利润 158,041,814.36 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 3,323,474,918.56 元，归属于母公司所有者的净资产为 2,798,706,259.51 元。

2 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

新金融工具准则

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日开始执行新金融工具准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整2019年年初未分配利润或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

本集团于2019年1月1日的金融资产均为按照摊余成本计量的金融资产。本集团已于首次执行日评估2019年1月1日计提的金融资产减值准备，按照预期信用损失模型重新计量不会对期初未分配利润产生重大影响。

在首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表：

		按原金融工具准则列 示的账面价值 2018年 12月31日	重分 类	重新 计量	按新金融工具准则列 示的账面价值 2019年 1月1日
本集团					
以摊余成本计量的金融资产					
应收账款					
按原金融工具准则列示的余额	5	238,920,558.19	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额		-	-	-	238,920,558.19
其他应收款					
按原金融工具准则列示的余额	8	11,138,984.40	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额		-	-	-	11,138,984.40
以摊余成本计量的总金融资产		<u>250,059,542.59</u>	-	-	<u>250,059,542.59</u>
以摊余成本计量的金融资产					
本公司					
附注十七					
应收账款					
按原金融工具准则列示的余额	1	586,987,548.14	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额		-	-	-	586,987,548.14
其他应收款					
按原金融工具准则列示的余额	2	19,463,753.01	-	-	-
按新金融工具准则列示的余额		-	-	-	19,463,753.01
以摊余成本计量的总金融资产		<u>606,451,301.15</u>	-	-	<u>606,451,301.15</u>

财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）要求，资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票

据”及“应付账款”；利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销；本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。此外，随本年新金融工具准则的执行，按照《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）要求，“其他应收款”项目中的“应收利息”改为仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），“其他应付款”项目中的“应付利息”改为仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息（基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中），参照新金融工具准则的衔接规定不追溯调整比较数据。

上述会计政策变更引起的追溯调整对财务报表的主要影响如下：

本集团	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	2018 年末余额	其他财务报表列报方式变更影响	2019 年初余额
应收票据及应收账款	238,920,558.19	-238,920,558.19	-
应收账款	-	238,920,558.19	238,920,558.19
应付票据及应付账款	274,469,168.44	-274,469,168.44	-
应付账款	-	274,469,168.44	274,469,168.44

本公司	会计政策变更前	会计政策变更	会计政策变更后
	2018 年末余额	其他财务报表列报方式变更影响	2019 年初余额
应收票据及应收账款	586,987,548.14	-586,987,548.14	-
应收账款	-	586,987,548.14	586,987,548.14
应付票据及应付账款	435,679,091.44	-435,679,091.44	-
应付账款	-	435,679,091.44	435,679,091.44

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，详见《晶晨半导体（上海）股份有限公司 2019 年年度报告》第十一节财务报告之八“合并范围的变更”。